## 世界知的所有権機関 国際事務局 特許協力条約に基づいて公開された国際出願



(51) 国際特許分類6 G01R 1/073, 1/067

(11) 国際公開番号 A1

WO99/04274

(43) 国際公開日

1999年1月28日(28.01.99)

(21) 国際出願番号

PCT/JP98/03131

(22) 国際出願日

1998年7月13日(13.07.98)

(30) 優先権データ 特願平9/188587

1997年7月14日(14.07.97)

JP

(71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について) 日本発条株式会社(NHK SPRING CO., LTD.)[JP/JP] 〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦3丁目10番地

Kanagawa, (JP)

(72) 発明者;および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ)

風間俊男(KAZAMA, Toshio)[JP/JP]

〒399-43 長野県上伊那郡宮田村3131番地

日本発条株式会社内 Nagano, (JP)

(74) 代理人

弁理士 大島陽一(OSHIMA, Yoichi)

〒162-0825 東京都新宿区神楽坂6-42 喜多川ビル7階

Tokyo, (JP)

(81) 指定国 CN, JP, KR, US, 欧州特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

添付公開發類

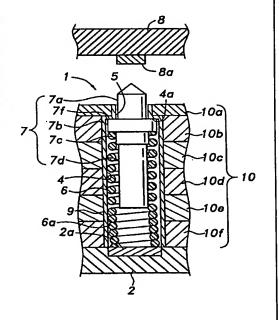
国際調查報告查

(54)Title: CONDUCTIVE CONTACT

(54)発明の名称 導電性接触子

(57) Abstract

A conductive contact having a holder member comprising a holed platelike member made of a material with a small coefficient of thermal expansion. When it is used in a high-temperature atmosphere, the thermal expansion of the holder member is minimized to avoid accumulated positional errors between spaced contacts to thereby ensure a high positional accuracy of the contacts. When the holder member has a laminated structure of a plurality of thin plate members, the thin plate members can be holed by etching, facilitating mass production. By performing an insulation treatment of the inner circumferential surface of the hole, the holder member can be made of a conductive material with a small coefficient of thermal expansion, thus widening a range of material selection for the holder member.



# (57)要約

孔あき加工された板状部材をホルダ部材とする導電性接触子に於いて、ホルダ部材を熱膨張率の小さな材料により形成し、高温雰囲気下での使用に於いて、ホルダ部材の熱膨張率を極小化し、離間した接触子間の累積的位置誤差を回避し、接触子の位置精度を確保した。ホルダ部材を複数の薄板部材の積層構造により形成した場合、薄板部材の孔あけをエッチングにより行うことができ、大量生産を容易に行い得る。孔の内周面に絶縁処理を施すことにより、熱膨張率が小さいが導電性の材質でホルダ部材を形成することができ、ホルダ部材の材質の選択幅を広げることができる。

AL アルバニア FI フィンランド LK スリ・ランカ SI スロヴェニア SK スロヴァニキア AT オーストリア GB 英位 LT リペリト SK スロヴァニキア AT オーストリア GB 英位 LT リルクトマニア SN セネガルンド TD チャーブ SN セネガルンド TD チャーブ SN セネガルンド TD チャード SN セネガルンド TD チャード SN セネガルンド TD チャード SN マスアジランド TD トージー TT サンキ MC モイド・ファソ GN ギニア MC モイド・ファソ GN ギニア MC マグド・アード TT ケジネスタン ファイボリア GN ギニア MG マグガスカル TM トルクスメニタン TM トルクリーグ・シャ・トバゴ US タボロ タッド・トバゴ US タボロ タッド・トバゴ US タボロ・カージボール US タボロ・カージボール IS アインドランド MW マグラン・ファンド MY マグ・エーノスラン CC コート・ジボアール IS アインドランド MW マグ・エー・ファンド PD オール・ファンド PD オール・ファンド PD オール・ファンド PD オール・ファンド PD オール・ファンド PD オール・アーカンド PD オール・アーカンド PD ボート・ジボアール KR 横衛 RU スーグ・ファーフンド PD ボール・ドランド PD ボート・ド・アーカー・アーカンド PD ボート・ド・アーカー・アーカンド PD ボート・ド・アーカー・アーカンド PD ボート・ド・アーカー・アーカンド PD ボート・ド・アーカンド PD ボート・ド・ド・アーカンド PD ボート・アーカンド PD ボート・アーカー・アーカンド PD ボート・アーカーカンド PD ボート・アーカート・アーカート・アーカート・アーカート・アーカート・アーカート・アーカート・アーカート・アーカート・アーカ

1

### 明細書

#### 導電性接触子

### 技術分野

本発明は、導電性針状体を圧縮コイルばねにより弾発付勢してなる導 電性接触子に関し、特に、プリント配線板や半導体素子の検査やウェハ テストを行うのに適する上記形式の導電性接触子に関する。

#### 背景技術

従来、プリント配線板の導体パターンや半導体製品などの電気的検査を行うためのコンタクトプローブに用いられる導電性接触子には、導電性針状体を筒状のホルダ内に軸線方向に出没自在に支持しかつ突出方向に抜け止めし、導電性針状体を圧縮コイルばねにより突出方向に弾発付勢するようにしたものがある。そのような導電性接触子にあっては、導電性針状体の突出方向先端を検査対象に弾発的に当接させて、電気信号を検査対象と外部回路との間で伝達するようにしている。

また、複数の検査ポイントを有する基板や多ピンの半導体素子に対して多点同時測定や検査を行うべく、板状の支持体に複数の孔をホルダとして設け、各孔内に導電性針状体と圧縮コイルばねとを受容した導電性接触子構造が同一出願人により提案されている(例えば特開平6-201725号参照)。

上記構造によれば、各導電性針状体毎に多数のパイプ状ホルダを製作する必要がないと共に、別部品のホルダを設ける必要がないことから各 導電性針状体間のピッチを極力狭めることができ、検査対象側の小ピッ チ化に好適に対応し得るという効果を奏する。

上記したように導電性針状体や導電性コイルばねを孔内に受容することから、板状支持体を絶縁性樹脂板やセラミックスを加工して形成して

いた。しかしながら、例えば直径が100mmを超えるような大面積の 支持板を用いて高温の雰囲気下で使用した場合には、熱膨張により各孔 (導電性針状体)の相対的な位置がずれてしまうという虞がある。

## 発明の開示

このような従来技術の問題点に鑑み、本発明の主な目的は、高密度に 配置可能であって、高温雰囲気でも適切に機能を果たし得る導電性接触 子を提供することにある。

本発明の第2の目的は、コンパクトで低コストな構成であって、高温 雰囲気でも適切に機能を果たし得る導電性接触子を提供することにある。

本発明の第3の目的は、大量生産に適し、高温雰囲気でも適切に機能 を果たし得る導電性接触子を提供することにある。

このような目的は、本発明によれば、導電性接触子であって、少なくとも1枚の板部材を含むホルダ部材に挿通され、前記ホルダ部材の第1の側にて小径部を画定するホルダ孔により形成されホルダと、前記ホルダ部材の第2の側にて、前記ホルダ孔に対向する配線パターンを有し、前記ホルダ部材の第2の側に取り付けられた基板と、前記ホルダ孔内にて軸線方向摺動可能に受容され、前記小径部から外向きに突出するべく適合された頭部及び該頭部の基端部側設けられた対応環状肩部によって係合されるべき環状肩部を有する導電性針状体と、前記導電性針状体を前記小径部から突出する向きに付勢するために、前記導電性針状体に対して同軸的をなすように前記ホルダ孔に受容された圧縮コイルばねとを有し、前記ホルダ部材が、熱膨張率の小さな材料からなることを特徴とする導電性接触子を提供することにより達成される。

このようにすることにより、熱膨張が小さいため、高温雰囲気下での 使用においても導電性接触子の位置ずれを極力防止し得る。また、ホル ダ部材を複数の薄板材の積層構造にすることにより、ホルダ孔の加工を容易に行うことができ、大量生産に対応し得る。この場合、小径部を、前記ホルダ部材を構成する薄板部材の最も外側にあるもののホルダ孔を小径とすることにより容易に形成することができる。

所要の機械的特性及び低熱膨張率を有する材料は、金属材料から容易に選択することができる。しかしながら、金属材料は、一般に導電性であることから、ホルダ部材を導電性針状体に対して電気的に絶縁する必要がある。導電性接触子を小型化するに伴い、物理的に絶縁層を形成することが困難になることから、絶縁皮膜を、ホルダ部材の材料の化学反応により形成するのが好ましい。通常、このような絶縁皮膜は、ホルダ部材の材料を酸化させたり、化学蒸着より形成することができる。ホルダ部材がシリコンウェハーからなる場合も、化学蒸着より形成により絶縁皮膜を形成することができ、また、絶縁皮膜は、耐久性が高く、化学的に安定な二酸化シリコンからなるものであって良い。

好ましくは、圧縮コイルばねが導電性材料からなり、電気信号を、導電性針状体から前記基板の配線パターンに伝達するべく適合されている。 それにより、導電性針状体から基板に電気信号を伝達するために別の手段を用いる必要がない。

#### 図面の簡単な説明

以下、本発明の好適実施例について図面を参照しながらより詳しく説明する。図面中、

第1図は、本発明が適用された導電性接触子の模式的縦断面図であり、 第2図は、本発明が適用された導電性接触子の他の実施の形態を示す 図1に対応する図である。

## 発明を実施するための最良の実施形態

図1は、本発明が適用された導電性接触子1の模式的縦断面図である。 なお、通常は複数の被接触箇所を設けられている検査対象に対して多点 同時検査を行うために、図に示されるような導電性接触子1を並列に複 数配設して用いる。

本導電性接触子1にあっては、図における下側にバーンインボードなどからなる基板2が設けられており、基板2の上面側には、その上面と同一面を形成する配線パターン2aが一体的に設けられている。上記基板2の図における上面には、ホルダ部材3が載置状態に設けられている。なお、ホルダ部材3と基板2とは図示されないねじなどの結合手段により互いに一体化されて使用されるものであって良い。

ホルダ部材3には、上記配線パターン2aに臨むように開設されたホルダ孔4が厚さ方向に貫通するように形成されており、図におけるホルダ部材3の上端部にはホルダ孔4よりも小径にされた小径孔部5が同軸的に設けられている。そのホルダ孔4内には、ホルダ孔4の内径よりも若干小径にされた圧縮コイルばね6が概ね同軸的に受容されていると共に、ホルダ孔4の図における上側部分には、導電性針状体7の一部が同軸的に受容されている。

その導電性針状体7は、上記小径孔部5を介して外方(図における上方)に出没し得るように、小径孔部5により同軸的に支持される頭部7 a と、ホルダ孔4内に受容されかつ小径孔部5よりも拡径されたフランジ部7bと、圧縮コイルばね6の内径よりも若干拡径されたカラー部7 c と、圧縮コイルばね6の内径よりも小径の軸部7dとをこの順に同軸的に形成されてなる。

ホルダ孔4内に受容された圧縮コイルばね6は、基板2とフランジ部7bとの間で圧縮変形した状態で組み付けられており、圧縮コイルばね

6の弾発力により、導電性針状体7をその頭部7aを外方に突出させる方向に付勢している。したがって、導電性針状体7は、組み付け状態では、ホルダ孔4の小径孔部5との境界として形成されている半径方向内向き段部4aにフランジ部7bの環状肩部7fを弾発的に衝当させており、そのようにして抜け止めされている。導電性針状体7と圧縮コイルばね6との間の電気的接続は、圧縮コイルばね6の上端を、導電性針状体7のカラー部7cに弾発的に嵌装することにより確保される。

このようにして組み付けられた導電性接触子1により、半導体素子などの被検査体8を検査する際には、導電性針状体7の頭部7aを被検査体8の端子8aに接触させて、基板2との間で電気信号の授受を行う。本発明による導電性接触子1にあっては、図1に示されるように、圧縮コイルばね6が圧縮変形により湾曲するため、圧縮コイルばね6の内周部の一部が軸部7dに接触する。また、圧縮コイルばね6にあっては、図1の待機状態(組み付け状態)で軸部7dと接触する部分から配線パターン2aに当接するコイル端に至るまでを密着巻きされている。

したがって、電気信号は、導電性針状体7の軸部7dから圧縮コイル ばね6の密着巻き部6aを軸線方向に流れ、配線パターン2aに達する。 なお、密着巻き部6aをコイル状に流れずに圧縮コイルばね6の軸線方 向に電気が流れ得ることから、高周波の場合に特に低インダクタンス化 及び低抵抗化を向上し得る。

なお、図に示されるように、平坦面形状の端子8 a の場合には導電性接触子7の頭部7 a の接触させる突出端を先鋭に形成して、皮膜などを突き破って確実に接触させるようにすると良いが、被検査体の端子が半田ボールのような場合には、導電性接触子7の頭部の突出端形状を平坦に形成すると良い。

6

本発明による導電性接触子1は、多数の端子に対して同時に接触させて検査などを行うのに適するものである。したがって、図1には単体のみが示されているが、比較的広い面積(径100mm以上)を有するホルダ部材3に、図1に示される導電性接触子1を互いに並列に複数配設して用いることができる。その際に、高温雰囲気下で検査などを行う場合には、ホルダ部材3の熱膨張による影響が大きいと、複数の導電性接触子1の離れたもの同士にあっては、一方を被検査体の対応する端子に合わせても、他方が対応する端子に合わなくなってしまう。

それに対して、本発明によれば、ホルダ部材3をガラス、セラミックス等の非金属材料や、シリコン、インバー(Invar)材などの金属材料からなる、熱膨張係数の小さい材質で形成している。また、ホルダ孔4の内周面に圧縮変形により湾曲した圧縮コイルばね6が接触するため、シリコンやインバー材などの導電材でホルダ部材3を形成した場合には、ホルダ部材3への電気の流れを阻止する必要がある。

本発明によれば、図1に示されるようにホルダ孔4及び小径孔部5の 内周面に絶縁処理としての絶縁皮膜9を形成している。これにより、ホルダ部材3に熱膨張係数が小さいが導電性を有する材質のものを用いて も、ホルダ部材3との間での絶縁性を確保することができる。

その絶縁皮膜9には、特に、シリコンウェハーには単純に加熱して形成した酸化皮膜を用いることができる。このようにすることにより、エッチングなどの加工方法により大量の対応が可能なため、絶縁皮膜9を各ホルダ孔4毎に形成することに何ら問題を生じることがない。なお、絶縁皮膜9にあっては、上記酸化皮膜に限ることなく、例えば樹脂やセラミック系のものを皮膜として形成しても良い。また、被膜を形成する方法として蒸着(CVDなど)も有効である。

いうまでもなく、ホルダ部材3が、ガラス、セラミックなどの非導電 材料からなる場合には、ホルダ孔4の絶縁処理は不要となる。

図2は、ホルダ部材3の別の形態を示す図1と同様の図である。なお、前記図示例と同様の部分には同一の符号を付してその詳しい説明を省略する。この図2に示されるものでは、複数枚の薄板10a~10fを多層に積層してホルダ部材10を構成し、図1と同様のホルダ孔4及び小径孔部5を形成している。すなわち、図2における最上層の薄板10aに小径孔部5を開設し、その下に積層される他の薄板10b~10fに積層状態でホルダ孔4を形成する同一径の孔をそれぞれ開設している。

各薄板10a~10f同士は、接着材による接着や、拡散接合、またはろう付けなどで互いに固着されている。そのようにして一体化された各薄板10a~10fによりホルダ部材10が形成され、そのホルダ孔4及び小径孔部5の内周面には前記と同様に絶縁皮膜9が形成されており、その効果は前記と同様である。絶縁皮膜9は、CVD、酸化その他の被着方法により形成でき、かつ薄板10a~10f同士の組付けの前或いは後に行うことができる。

なお、この積層構造によれば、薄板に対して孔加工するため、ホルダ 孔4及び小径孔部5の加工を容易に行うことができ、上記インバー材や シリコンにあってはエッチングなどの一括処理が可能であるため、1枚 の板材に多数の孔加工を施す場合や大量に生産する場合に、導電性接触 子1つ当たりの加工時間を短縮でき、コストダウンを向上し得る。

このように本発明によれば、熱膨張率の小さな材質のホルダ部材に孔 加工してホルダを形成したことから、高温雰囲気下での使用においても ホルダ部材の熱膨張が小さく、複数の導電性接触子を配設した場合の互 いに離れたもの同士間のピッチが大きくずれてしまうことがなく、高温

8

雰囲気下での複数の導電性接触子間の位置ずれが生じることを防止し得る。また、薄板の積層構造によりホルダ部材を形成することにより、薄板に対する孔加工をエッチングなどにより容易に行うことができ、大量生産を容易に行い得る。また、孔の内周面に絶縁処理を施すことにより、熱膨張率が小さいが導電性の材質でホルダ部材を形成することができ、ホルダ部材の材質の選択幅を広げることができる。

以上、本発明を特定の実施例について説明したが、当業者であれば、 請求の範囲に記載された本発明の概念から逸脱することなく、種々の変 形・変更が可能である。

## 請求の範囲

1. 導電性接触子であって、

少なくとも1枚の板部材を含むホルダ部材に挿通され、前記ホルダ部 材の第1の側にて小径部を画定するホルダ孔により形成されホルダと、

前記ホルダ部材の第2の側にて、前記ホルダ孔に対向する配線パターンを有し、前記ホルダ部材の第2の側に取り付けられた基板と、

前記ホルダ孔内にて軸線方向摺動可能に受容され、前記小径部から外向きに突出するべく適合された頭部及び該頭部の基端部側設けられた対応環状層部によって係合されるべき環状層部を有する導電性針状体と、

前記導電性針状体を前記小径部から突出する向きに付勢するために、前記導電性針状体に対して同軸的をなすように前記ホルダ孔に受容された圧縮コイルばねとを有し、

前記ホルダ部材が、熱膨張率の小さな材料からなることを特徴とする 導電性接触子。

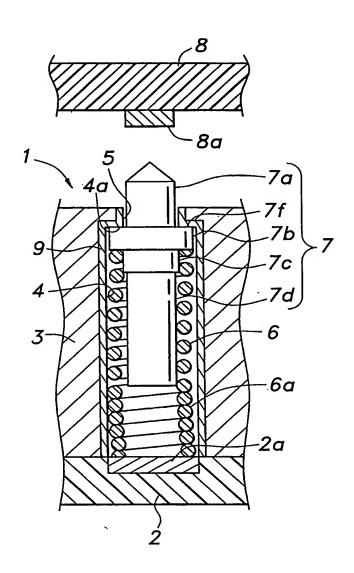
- 2. 前記ホルダ部材の前記材料が概ね導電性であって、前記ホルダ孔の 内周面に絶縁性皮膜が設けられていることを特徴とする請求項1に記載 の導電性接触子。
- 3. 前記圧縮コイルばねが導電性材料からなり、電気信号を、前記導電性針状体から前記基板の前記配線パターンに伝達するべく適合されていることを特徴とする請求項2に記載の導電性接触子。
- 4. 前記ホルダ部材が、複数の薄板部材を積層してなることを特徴とす

る請求項1に記載の導電性接触子。

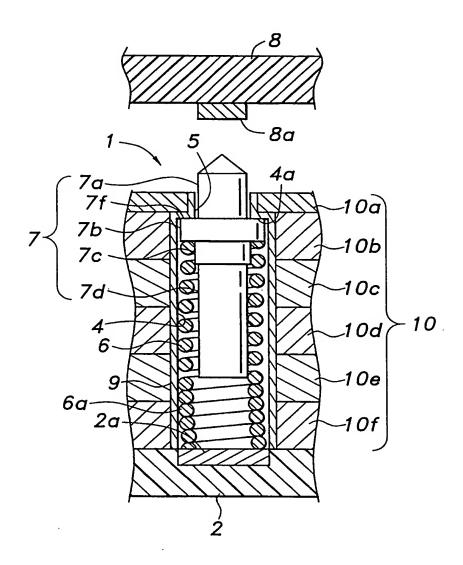
- 5. 前記ホルダ部材の前記第1の側にある前記薄板部材が、前記小径部を画定するべく小径ホルダ孔を有することを特徴とする請求項1に記載の導電性接触子。
- 6. 前記ホルダ部材が金属板部材を有し、前記絶縁性皮膜が、前記ホルダ部材の材料の化学反応により形成されていることを特徴とする請求項2に記載の導電性接触子。
- 7. 前記ホルダ部材がシリコンウェハーを有し、前記絶縁性皮膜が、前記ホルダ孔の内周面を酸化させて形成されていることを特徴とする請求項6に記載の導電性接触子。
- 8. 前記ホルダ部材がシリコンウェハーを有し、前記絶縁性皮膜が、前記ホルダ孔の内周面に化学蒸着を行うことにより形成されていることを特徴とする請求項6に記載の導電性接触子。
- 9. 前記ホルダ部材が金属板部材を有し、前記絶縁性皮膜が、前記ホルダ孔の内周面に化学蒸着を行うことにより形成されていることを特徴とする請求項6に記載の導電性接触子。

1/2









# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP98/03131

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl <sup>6</sup> G01R1/073, G01R1/067						
According to	o International Patent Classification (IPC) or to both nat	tional classification and IPC				
	SSEARCHED					
Int.	ocumentation searched (classification system followed b C1 <sup>6</sup> G01R1/073, G01R1/067, G01R	RŠ1/28, HOÍL21/66, GO1R				
Jitsu	Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched  Jitsuyo Shinan Koho 1940-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-1998  Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-1998 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-1998					
Electronic d	ata base consulted during the international search (nam	ne of data base and, where practicable, so	earch terms used)			
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category*	Citation of document, with indication, where app		Relevant to claim No.			
·	JP, 3-202780, A (Shinko Elec Co., Ltd.),					
х	4 September, 1991 (04. 09. 9) Full text ; Figs. 1, 2 (Fami		1, 3, 4			
Ÿ	Full text; Figs. 1, 2 (Fami		1-9			
Y	JP, 9-54116, A (Nippon Denshi Zairyo K.K.), 25 February, 1997 (25. 02. 97), Full text ; Fig. 1 (Family: none)		1, 3, 4			
Y	JP, 8-23013, A (Ejingutesuta Kumiai),	-	1-3, 6-9			
	23 January, 1996 (23. 01. 96) Full text ; Figs. 1 to 6 (Fa					
Y	JP, 64-71141, A (Hitachi, Lt	:d.),	5			
	16 March, 1989 (16. 03. 89), Full text ; Fig. 3	İ				
	& US, 4931726, A	İ				
		İ				
× Furthe	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.	<u>L</u>			
	I categories of cited documents: ent defining the general state of the art which is not	"T" later document published after the inter- date and not in conflict with the applica				
conside	ent detining the general state of the art which is not ered to be of particular relevance document but published on or after the international filing date	the principle or theory underlying the in "X" document of particular relevance; the cl	ovention			
"L" docum	document but published on or after the international filing date tent which may throw doubts on priority claim(s) or which is o establish the publication date of another citation or other	considered novel or cannot be considered when the document is taken alone				
special	reason (as specified) tent referring to an oral disclosure, use, exhibition or other	"Y" document of particular relevance; the considered to involve an inventive step				
means  "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed  "Combined with one or more other such documents, such combined with one or more other such documents, such combined with one or more other such documents, such combined with one or more other such documents, such combined with one or more other such documents, such combined with one or more other such documents, such combined with one or more other such documents, such combined with one or more other such documents, such combined with one or more other such documents, such combined with one or more other such documents, such combined with one or more other such documents, such combined with one or more other such documents, such combined with one or more other such documents, such combined with one or more other such documents.			documents, such combination art			
Date of the actual completion of the international search 2 October, 1998 (02. 10. 98)  Date of mailing of the international search report 13 October, 1998 (13. 10. 98)						
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer				
Facsimile No.		Telephone No.				

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP98/03131

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No
Y	JP, 6-148236, A (NHK Spring Co., Ltd.), 27 May, 1994 (27. 05. 94), Full text; Figs. 1 to 3 & US, 5410260, A	5
Y	JP, 8-39855, A (Alps Electric Co., Ltd.), 13 February, 1996 (13. 02. 96), Claim 4 (Family: none)	7
Y	JP, 7-115253, A (Hitachi Chemical Co., Ltd.), 2 May, 1995 (02. 05. 95), Par. No. [0008] (Family: none)	8, 9
Y	JP, 10-38920, A (Sankyo Seiki Mfg. Co., Ltd.), 13 February, 1998 (13. 02. 98), Full text ; Figs. 1 to 4 (Family: none)	1, 3-5
Y	JP, 10-19930, A (NHK Spring Co., Ltd.), 23 January, 1998 (23. 01. 98), Full text ; Figs. 1 to 3 (Family: none)	1, 3-5
Y	JP, 10-111315, A (Mitsubishi Electric Corp.), 28 April, 1998 (28. 04. 98), Full text; Fig. 1 & TW, 313688, A	

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1992)

A. 発明の原	国する分野の分類(国際特許分類(IPC))		
Int.	C1° G01R1/073, G01R	1/067	
B. 調査を行	テった分野		
	b小限資料(国際特許分類(IPC))		
Int.	C1° G01R1/073 , G01R3 G01R31/28 , H01L3	1/067 21/66 , G01R31/02	
	トの資料で調査を行った分野に含まれるもの		
日本国	実用新案公報 1940-1996年		
日本国	公開実用新案公報 1971-1998年 登録実用新案公報 1994-1998年		
日本国	実用新案登録公報 1996-1998年		
国際調査で使用	用した電子データベース (データベースの名称、	調査に使用した用語)	
	•		
			····
引用文献の	3 C 83 00 4 10 X IIIX	·	関連する
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連すると	:きは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
	JP, 3-202780, A (新光電気工業株式	会社)	
	04.9月.1991 (04.09.91)	×1. \	1 0 4
X Y	全文, 第1-2図(ファミリーな 全文, 第1-2図(ファミリーな	rl)	1, 3, 4 1-9
Y	JP, 9-54116, A (日本電子材料株式会	<b>会社)</b>	1, 3, 4
	25.2月.1997 (25.02.97) 全文, 第1図 (ファミリーなし)		
Y	JP, 8-23013, A (エージングテスタ目	<b>開発協同組合)</b>	1-3, 6-9
_	23.1月.1996 (23.01.96)		" ", " "
	全文、第1-6図(ファミリー)	なし)	
X C欄の続	きにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	紙を参照。
* 引用文献		の日の後に公表された文献	
I A」符に関わ	連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す	「T」国際出願日又は優先日後に公表: て出願と矛盾するものではなく、	
	<b>献ではあるが、国際出願日以後に公表されたも</b>	論の理解のために引用するもの	
n		「X」特に関連のある文献であって、?	当該文献のみで発明
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する		の新規性又は進歩性がないと考え 「Y」特に関連のある文献であって、	-
文献(理由を付す)		上の文献との、当業者にとって	
	よる開示、使用、展示等に言及する文献 願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	よって進歩性がないと考えられ 「&」同一パテントファミリー文献	るもの
国際調査を完	了した日 02.10.98	国際調査報告の発送日 13.10.5	98
国際調査機関の名称及びあて先		特許庁審査官 (権限のある職員)	2G 8908
日本国特許庁 (ISA/JP)		中塚直樹 月	
	郵便番号100-8915 都千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101	内線 3226

C(続き).	関連すると認められる文献	<del></del>
引用文献の		関連する
カテゴリー* Y	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 JP,64-71141,A (株式会社日立製作所) 16.3月.1989(16.03.89) 全文,第3図 & US,4931726,A	請求の範囲の番号
Y	JP,6-148236,A(日本発条株式会社) 27.5月.1994(27.05.94) 全文,第1 — 3 図 & US,5410260,A	5
Y	JP, 8-39855, A(アルプス電気株式会社) 13. 2月. 1996(13. 02. 96) 請求項4 (ファミリーなし)	7
Y	JP, 7-115253, A(日立化成工業株式会社) 02. 5月. 1995(02. 05. 95) 段落番号【0008】 (ファミリーなし)	8,9
Y	JP, 10-38920, A(株式会社三協精機製作所) 13. 2月. 1998(13. 02. 98) 全文,第1-4図 (ファミリーなし)	1, 3-5
Y	JP, 10-19930, A(日本発条株式会社) 23.1月.1998(23.01.98) 全文,第1−3図 (ファミリーなし)	1, 3-5
Y	JP, 10-111315, A(三菱電機株式会社) 28.4月.1998(28.04.98) 全文,第1図 & TW, 313688, A	
· 		